



平成24年3月期  
第2四半期決算説明会資料

平成23年11月14日（大阪）

平成23年11月15日（東京）

石原薬品株式会社

（東証二部・大証二部）

# 目 次

## ➤ 平成24年3月期 第2四半期 決算の概要 (代表取締役社長 竹森 莞爾)

- 平成24年3月期 第2四半期 決算の概要
- 平成24年3月期 第2四半期累計期間の営業の状況
- 平成24年3月期 業績予想・業績予想のポイント
- 株主還元・内部留保の考え方
- 中期経営計画について

## ➤ 決算の詳細 (常務取締役 浅野 真司)

- 損益計算書の概要
- 営業品目別売上高3期比較
- 製品・商品別売上高比率・売上総利益率・輸出比率推移
- 貸借対照表の概要
- キャッシュ・フロー計算書の概要
- キャッシュ・フローと設備投資額の推移

## ➤ 新技術、新製品開発の状況 (代表取締役専務 時澤 元一)

- 技術動向
- 新製品開発の状況 (フォトシタリング型導電性銅ナノインクについて)
- めっき製品紹介
- 部品紹介

### 《参考資料》

- 経営の基本方針
- 当社の特徴
- 営業品目別売上高推移 (平成13年度実績～平成23年度予想)
- 研究開発人員と研究開発費
- 業績の推移と配当
- 総資産・純資産・1株当たり純資産・自己資本比率の推移

# 平成24年3月期 第2四半期 決算の概要

(代表取締役社長 竹森 莞爾)

- ① わが国経済は、東日本大震災後の停滞を脱し回復の途上にあったが、欧州の債務問題への懸念などから、米欧景気の減速など世界経済の変調が新たな不安として浮上。円高の進行や長期化、株式市場の低迷等、先行き不透明な状況。
- ② 上期の状況は、電子関連分野の金属表面処理剤の輸出を中心に旺盛な需要があり伸長。

(単位：億円)

	前第2四半期 累計期間(a)	当第2四半期 累計期間(b)	差異 (b)-(a)	修正発表値	修正発表 との差異
売上高	72.7	78.4	5.7	76.2	2.2
売上総利益	20.1	19.3	△0.8	19.3	0.0
営業利益	5.6	3.8	△1.8	3.7	0.1
経常利益	5.7	4.0	△1.7	4.0	0.0
四半期純利益	1.3	2.4	1.2	2.2	0.2
1株当たり四半期純利益(円)	18.65	33.49		29.49	

(平成23年7月28日発表)

## 前第2四半期との差異内容

### ◆ 売上高 (+5.7億円)

製品売上	△3.2億円
商品売上	+8.9億円

金属表面処理剤 及び機器等	+6.2億円
電子材料	△1.5億円
自動車用化学製品等	+0.3億円
工業薬品	+0.7億円

### ◆ 売上総利益 (△0.8億円)

製品売上総利益	△2.1億円
商品売上総利益	+1.3億円

### ◆ 四半期純利益 (+1.2億円)

売上総利益	△0.8億円
販管費増	△1.0億円
営業利益	△1.8億円
営業外損益	+0.1億円
経常利益	△1.7億円
特別損益	+2.3億円
法人税等	+0.6億円
当期純利益	+1.2億円

# 平成24年3月期 第2四半期累計期間の営業の状況

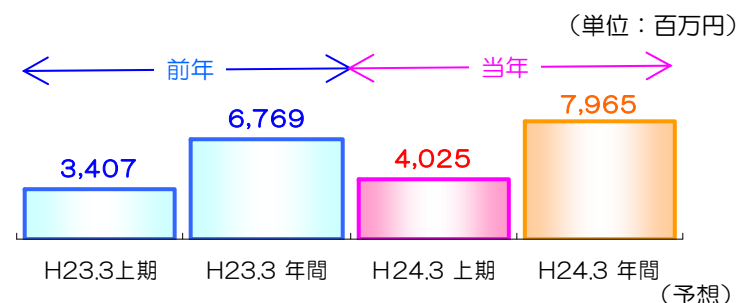
## 金属表面処理剤及び機器等

### 金属表面処理剤

- ① 国内市場は震災によるユーザーの生産の停滞、海外工場への生産移管等、完全には回復に至っていない状況。
- ② 国内外ともに、薄型テレビ、パソコンなど販売の低迷により在庫のだぶつきから電子部品・半導体の需要が減速、対応するめっき液の需要が低迷。
- ③ 海外市場は拡大するスマートフォン等の需要増に関連し、台湾・韓国ユーザー向けシリコンウェハーバンプ用めっき液の需要が大きく伸長。

### 機器等「化成処理液自動管理装置」

- ・海外を中心にプリント基板、タッチパネル等スマートフォン関連の生産工程に多く採用され、受注を伸ばした。



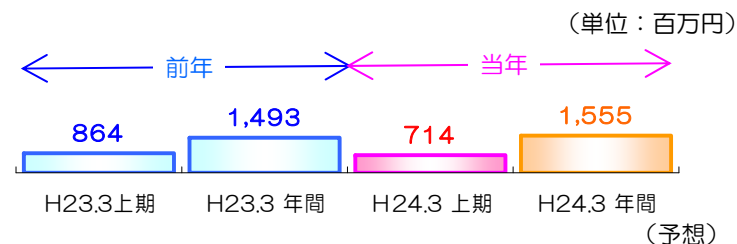
## 電子材料

### ニッケル超微粉

- ・ユーザーのセラミックコンデンサの生産状況もあり、需要は低迷。

### 機能材料加工品

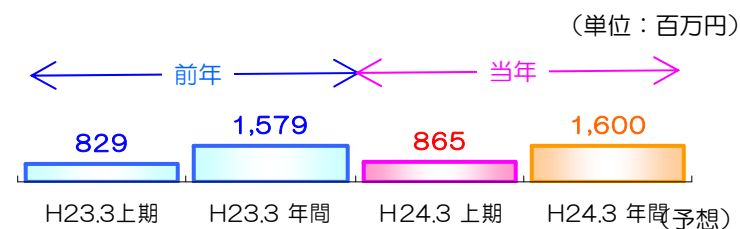
- ・半導体製造装置業界向けの部品需要増により伸長。



# 平成24年3月期 第2四半期累計期間の営業の状況

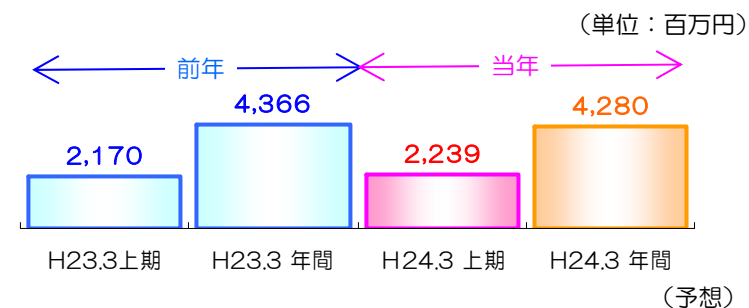
## 自動車用化学製品等

- 統廃合によるガソリンスタンドの減少、事故率の低下、補修に対する価値観の変化等で市場規模の縮小傾向が続く。
- OEM商材のエアコン洗浄剤、補修用コンパウンドの拡大等の促進。



## 工業薬品

- 鉄鋼分野は特殊鋼、高級鋼の需要が旺盛で関連する薬剤の需要は堅調に推移。
- 化学関連分野は海外向け塩ビ触媒が円高等不振で低迷。



# 平成24年3月期の業績予想

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(単位：億円、%)

	平成23年3月期 (実績)			平成24年3月期			
	上期	下期	年間	上期 (実績)	下期 (予想)	年間(予想) (修正計画)	増減率
売上高	72.7	69.3	142.0	78.4	75.6	154.0	8.4%
営業利益	5.6	3.6	9.2	3.8	2.7	6.5	△ 29.6%
経常利益	5.7	3.7	9.4	4.0	3.0	7.0	△ 26.0%
当期純利益	1.3	3.2	4.58	2.4	2.1	4.50	△ 1.8%
1株当たり当期純利益(円)	/		65.67	/		60.32	/
1株当たり配当額(円)	/		35.00	/		30.00	/

(平成23年10月28日発表)



業績予想数値につきましては、現時点において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。

# 平成24年3月期の業績予想のポイント

## 売上高

- (1) スマートフォン等の需要増でハイエンドの電子部品の使用が伸びることから台湾・韓国を中心にシリコンウェハーバンプ向けめっき液の需要は引き続き伸びる模様。  
IC半導体、チップ部品、COF向けめっき液はあまり大きく伸びないと予想。
- (2) 自動車用化学製品等、OEM商材のエアコン洗浄剤の拡販、補修用コンパウンド新製品の拡販の推進による伸びを予想。

## 売上総利益

商品の伸びによる販売構成の変化により、売上総利益率低下。  
製品の売上総利益率の低下、商品の売上総利益率の向上。

## 経費・人件費

費用節減に努めつつ、販路拡大等市場開拓に関する費用・研究開発費用は積極的に投入する。

## 研究開発費：940百万円計画

金属表面処理剤や電子材料分野を中心に新製品開発、新技術開発の促進。

(ナノ粒子関連等、新規電子材料の開発)

## 設備投資：1,030百万円計画

生産場所の分散による生産体制のリスクヘッジ及び新規電子材料の事業化に向け、工場取得、生産設備増強。

# 株主還元・内部留保の考え方

## 平成24年3月期の配当予想

安定配当を基本としつつも、業績、経営環境、財務状況を勘案し、中間配当15円、期末配当金15円の年間配当金30円を予定。

## 株主還元の基本方針

安定的かつ継続的な配当を基本としつつ、業績に応じ増配を検討するなど弾力的な還元策を図っていく方針であります。自己株式の取得等も資本政策として合わせて検討し、株主の皆さまに満足していただける株主還元を検討してまいります

## 内部留保

健全な経営基盤を維持するため内部留保の充実を図ってまいりますとともに、その活用については、研究開発や新事業、新技術開発など将来の企業価値を高めるための投資に優先して充当してまいります。

なお、株主還元と内部留保のバランスについては、当社のおかれた環境を考慮して慎重に検討を継続してまいります。

## 中期経営計画について（平成22年度～平成24年度予想）

### 数値目標

（注）

	平成23年3月期 実績（構成比）	平成24年3月期 予想（構成比）	平成25年3月期 予想（構成比）
製品売上高	60.8 億円 (42.8%)	56.2 億円 (36.5%)	77.6 億円 (45.1%)
商品売上高	81.2 億円 (57.2%)	97.8 億円 (63.5%)	94.5 億円 (54.9%)
計	142.0 億円	154.0 億円	172.1 億円
経常利益	9.4 億円	7.0 億円	19.0 億円
当期純利益	4.5 億円	4.5 億円	11.8 億円
売上高 経常利益率	6.7 %	4.5%	11.0%

（注）東日本大震災による直接的な、当社への人的、物的影響はありませんでしたが、当該震災に起因する当社への影響につきましては、継続的に情報収集、分析、評価等を行い、業績予想に反映させてきております。

なお、平成25年3月期につきましては、平成22年6月発表の値から見直しは行っておりません。

# 中期経営計画について

## 基本的な取り組み方針

- (1) 基礎となる3つの分野、4つの事業をバランスよく展開し、各々の事業の収益力を高め、その総体として会社の業績の伸長をはかる。
  - ① めっき分野の利益率の5%改善
  - ② その他の分野の利益構造の改善
- (2) 電子材料関連分野を重点開発分野と位置づけ第5の事業を立ち上げる。
  - ① 回路形成用銅めっき液の市場へ参入、展開  
(平成24年度には4億円程度見込む)
  - ② 金属ナノ粒子を用いた電子回路形成材料の開発 (数値的には未算入)
- (3) 新製品開発、新技術開発のため研究開発投資を積極的に行う。
- (4) 生産場所の分散による生産体制のリスクヘッジ及び生産能力の視点から工場取得、生産設備の増強をはかっていく。

# 中期経営計画について

## 目標とする経営指標

- (1) 自社製品の売上拡大により、製品売上高の構成比50%以上を目標とし、売上総利益の拡大をはかる。
- (2) 売上高経常利益率10%以上を目標とする。
- (3) ROE（自己資本当期純利益率）・EPS（1株当たり当期純利益）の向上をはかる。

	14/3	15/3	16/3	17/3	18/3	19/3	20/3	21/3	22/3	23/3	24/3 (予想)
製品割合 (%)	40.2	38.9	41.8	42.3	48.8	49.3	45.2	40.7	42.8	42.8	36.5
売上高経常利益率 (%)	3.9	6.4	8.3	10.2	12.3	12.5	10.1	3.2	4.9	6.7	4.5
ROE (%)	2.0	4.6	6.9	9.1	9.6	9.2	6.9	-0.6	4.9	3.5	3.3
EPS (円/株)	24.85	56.73	88.77	126.03	145.09	155.00	121.10	-9.76	87.10	65.67	60.32

当社を取り巻く外部環境は日々刻々と変化し、現在のような金融環境の激変期あつては、ROEの向上とともに企業の持続性も重要な経営課題として認識しております。

このような状況のもとでは、強固な財務状況を維持し、株主、取引先等、全てのステークホルダーに安心していただける基盤の整備も重要であると考えております。

# 決算の詳細 (常務取締役 浅野 真司)

## 損益計算書の概要

(単位：百万円)

	平成23年3月期 (年間)		前第2四半期 累計期間		当第2四半期 累計期間		増減金額
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	
売上高	14,209	100%	7,272	100%	7,844	100%	572
売上原価	10,362	72.9%	5,258	72.3%	5,917	75.4%	659
売上総利益	3,846	27.1%	2,013	27.7%	1,926	24.6%	△ 86
販売費及び 一般管理費	2,923	20.6%	1,447	19.9%	1,544	19.7%	97
営業利益	922	6.5%	566	7.8%	382	4.9%	△ 183
営業外収益	86	0.6%	46	0.6%	49	0.6%	2
営業外費用	63	0.4%	34	0.5%	30	0.4%	△ 4
経常利益	945	6.7%	578	8.0%	401	5.1%	△ 177
特別利益	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0
特別損失	301	2.1%	253	3.5%	15	0.2%	△ 237
税引前 四半期純利益	645	4.5%	325	4.5%	386	4.9%	60
法人税等	187	1.3%	196	2.7%	136	1.7%	△ 60
四半期純利益	458	3.2%	129	1.8%	249	3.2%	120

### \* 売上高 … +572百万円

製品売上 … △321百万円

商品売上 … +894百万円

輸出比率 30.7% → 31.5% → 40.3%  
(前第2四半期) (H23.3期) (当第2四半期)

### \* 売上総利益 … △86百万円

売上総利益率 27.7% → 27.1% → 24.6%

(前第2四半期) (H23.3期) (当第2四半期)

売上構成の変化

製商品割合	製品	商品
(当第2四半期)	36.6%	: 63.4%
(H23.3期)	42.8%	: 57.2%
(前第2四半期)	44.0%	: 56.0%

売上総利益率の変化

	製品	商品
(当第2四半期)	46.3%	: 11.9%
(H23.3期)	47.8%	: 11.5%
(前第2四半期)	48.4%	: 11.4%

### \* 販売費及び一般管理費 … +97百万円

① 研究開発費 … +42百万円

② 販売手数料 … +28百万円

③ 特許等申請維持費 … +17百万円

④ 運賃通関諸掛等 … +10百万円

### \* 特別損失 … △237百万円

投資有価証券評価損減少他

### \* 法人税等 … △60百万円

# 営業品目別売上高3期比較

(単位：億円，%)

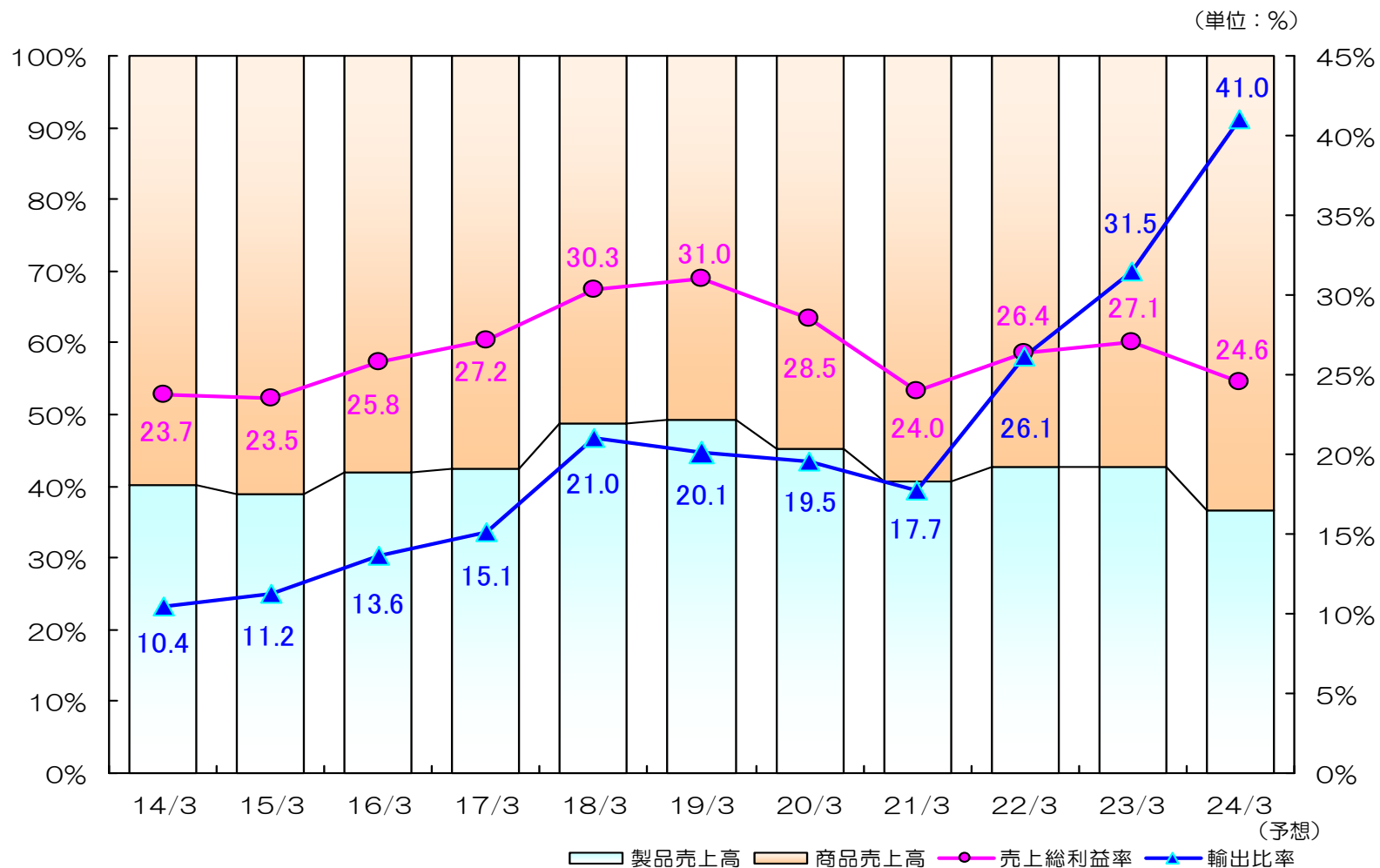
	前第2四半期 (a)		当第2四半期 (b)		差異 (b)-(a)	年間 業績予想
<b>製品</b> 金属表面処理剤及び機器等	23.7	32.7%	19.3	24.6%	△4.4	38.2
電子材料	1.5	2.1%	1.6	2.0%	0.1	3.5
電子関連分野 計	25.2	34.8%	20.9	26.6%	△4.3	41.7
自動車用化学製品等	5.6	7.7%	6.5	8.4%	0.9	12.1
工業薬品	1.0	1.5%	1.2	1.6%	0.2	2.4
製品合計	31.9	44.0%	28.7	36.6%	△3.2	56.2
<b>商品</b> 金属表面処理剤及び機器等	10.3	14.2%	20.9	26.7%	10.6	41.4
電子材料	7.1	9.8%	5.5	7.0%	△1.6	12.0
電子関連分野 計	17.4	24.0%	26.4	33.7%	9.0	53.4
自動車用化学製品等	2.7	3.7%	2.1	2.7%	△0.6	3.9
工業薬品	20.6	28.3%	21.1	27.0%	0.5	40.4
商品合計	40.7	56.0%	49.6	63.4%	8.9	97.8
合計	72.7	100.0%	78.4	100.0%	5.7	154.0

(平成23年10月28日発表)



業績予想数値につきましては、現時点において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。

# 製品・商品別売上高比率・売上総利益率・輸出比率推移



# 貸借対照表の概要

(単位：百万円)

	平成23年3月期 (年間)	当第2四半期 累積期間	増減金額
(資産の部)			
流動資産	8,979	8,902	△ 77
現預金	4,145	4,027	△ 118
売上債権	3,525	3,697	172
有価証券	70	1	△ 69
棚卸資産	1,084	1,046	△ 37
その他	154	130	△ 24
固定資産	7,967	8,271	304
有形固定資産	2,599	2,596	△ 3
無形固定資産	42	42	0
投資その他の資産	5,325	5,633	307
資産合計	16,947	17,173	226
(負債の部)			
流動負債	3,101	3,271	170
仕入債務	2,560	2,642	82
1年以内返済予定 長期借入金	24	20	△ 4
その他	517	608	91
固定負債	526	523	△ 3
長期借入金	8	—	△ 8
その他	519	523	4
負債合計	3,628	3,795	166
(純資産の部)			
純資産合計	13,318	13,378	60
負債・純資産合計	16,947	17,173	226

## 主な資産・負債の増減内容

- \* 現預金・・・△118百万円
- \* 有価証券、投資有価証券・・・+213百万円
  - ① 償還 △270百万円
  - ② 運用 +551百万円
  - ③ 評価替 △68百万円
- \* 棚卸資産・・・△37百万円
  - ① 商品 △59百万円
  - ② 製品 +10百万円
  - ③ 原材料・貯蔵品 +12百万円
- \* 流動資産（その他）・・・△24百万円
- \* 有形固定資産・・・△3百万円
  - ① 設備投資 +132百万円
  - ② 減価償却費 △135百万円
- \* 仕入債務・・・+82百万円
- \* 流動負債（その他）・・・+91万円
  - ① 未払法人税 +60百万円
  - ② 設備未払金 +11百万円
  - ③ 設備支払手形 +20百万円
- \* 固定負債（その他）・・・+4百万円
  - ① 長期リース債務 +28百万円
  - ② 退職給付引当金他 △23百万円
- \* 純資産・・・+60百万円

## キャッシュ・フロー計算書の概要

現金及び現金同等物の増加・・・△111百万円（期末残高 4,025百万円）

\* 営業活動によるキャッシュ・フロー・・・391百万円

減価償却費 151百万円、売上債権増加 172百万円

仕入債務増加 82百万円、法人税等支払 77百万円等

\* 投資活動によるキャッシュ・フロー・・・△313百万円

有価証券取得による支出 549百万円、売却・償還による収入 270百万円

有形固定資産取得による支出 35百万円等

\* 財務活動によるキャッシュ・フロー・・・△186百万円

配当金支払 149百万円等

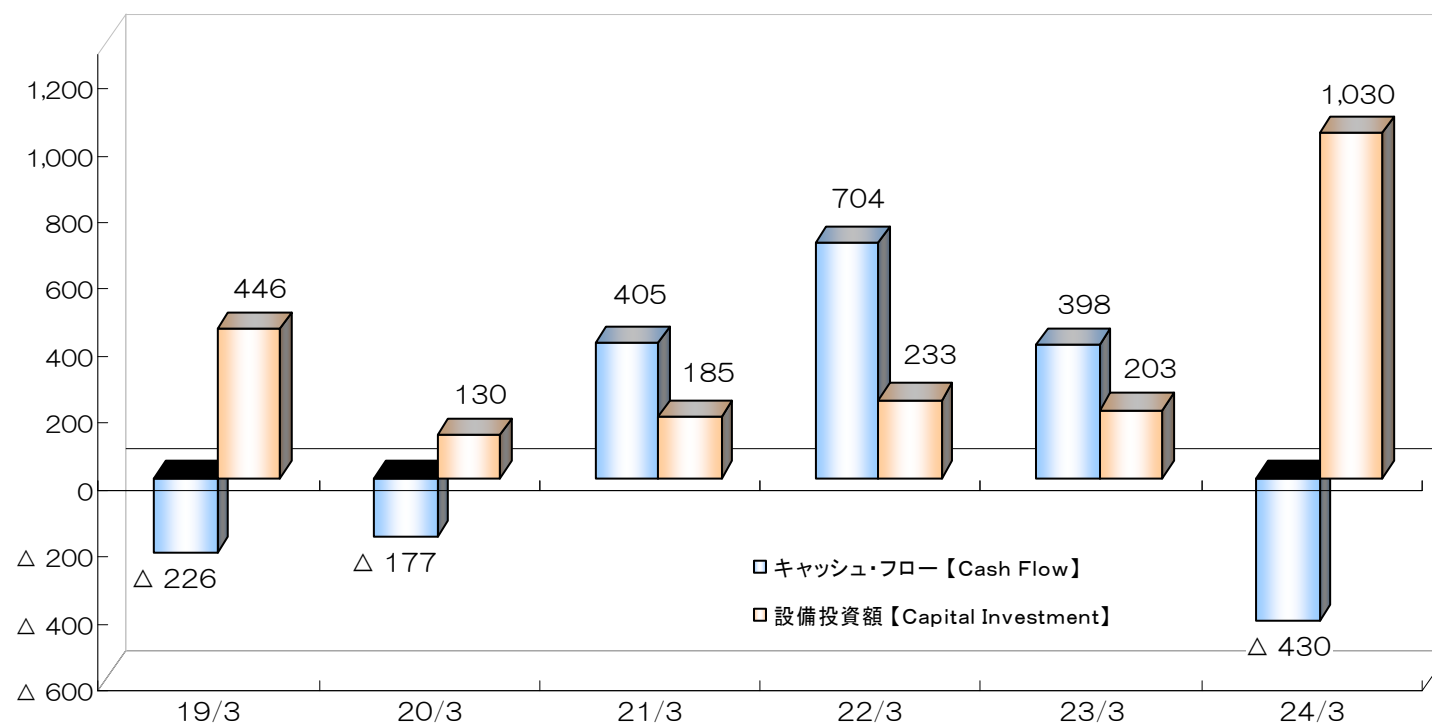
（単位：百万円）

	前第2四半期 累積期間	当第2四半期 累積期間
営業活動によるキャッシュ・フロー	492	391
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 258	△ 313
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 90	△ 186
現金及び現金同等物の増減額	129	△ 111
現金及び現金同等物の期首残高	3,738	4,136
現金及び現金同等物の期末残高	3,867	4,025

# キャッシュ・フローと設備投資額の推移

(単位：百万円)

	19/3	20/3	21/3	22/3	23/3	24/3 (予想)
キャッシュ・フロー【Cash Flow】	△ 226	△ 177	405	704	398	△ 430
設備投資額【Capital Investment】	446	130	185	233	203	1,030
減価償却費【Depreciation Expenses】	239	252	270	259	310	370



# 新技術・新製品開発の状況

(代表取締役専務 時澤 元一)

## ● 技術動向

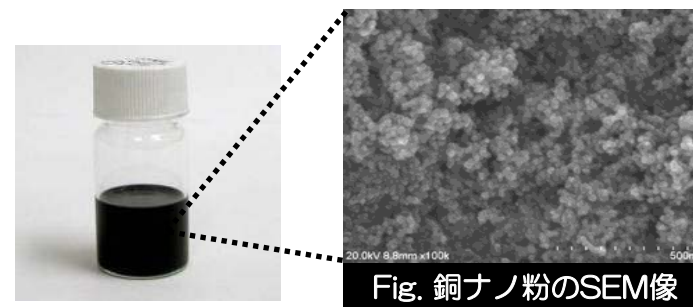
はんだめっきの技術動向

## ● 新製品開発の状況

### フォトシタリング型導電性銅ナノインクについて

#### 概 要

フォトシタリング型導電性銅ナノインクはポリイミド等の基板へ印刷後、フラッシュランプ照射により、1秒以下の短時間で焼成可能です。得られた皮膜は、純銅の数倍程度の非常に小さい比抵抗であり、基板との密着性も良好であり、回路形成をはじめとして様々な分野へ適用可能です。

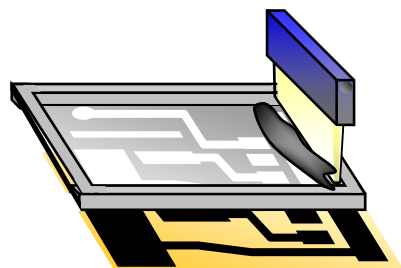


#### 特 徴

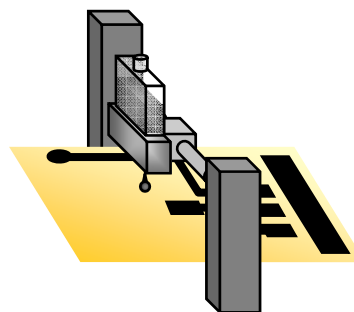
- ① 大気下、室温、短時間で焼成可能プロセスであり Roll to Rollへの適用も可能です。
- ② 純銅に近い比抵抗の皮膜が得られます。
- ③ めっき法による増膜が可能です。

# フォトシンタリングプロセス

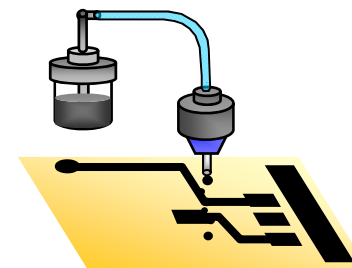
## 1.印刷



スクリーン印刷



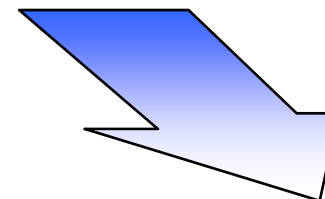
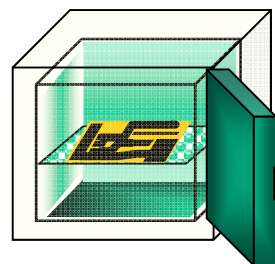
インクジェット印刷



Aerosoljet®

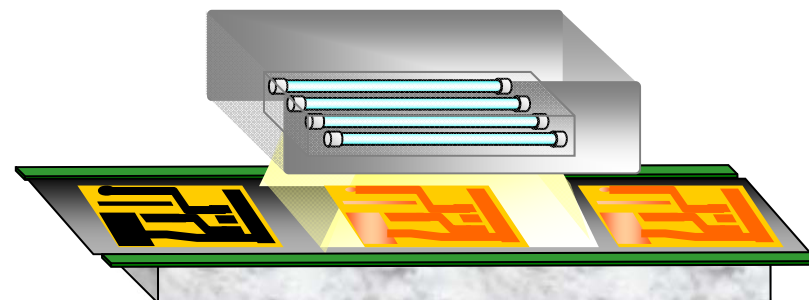
## 2.乾燥

雰囲気 : 大気下  
乾燥温度 : 室温～  
乾燥時間 : 5分以下

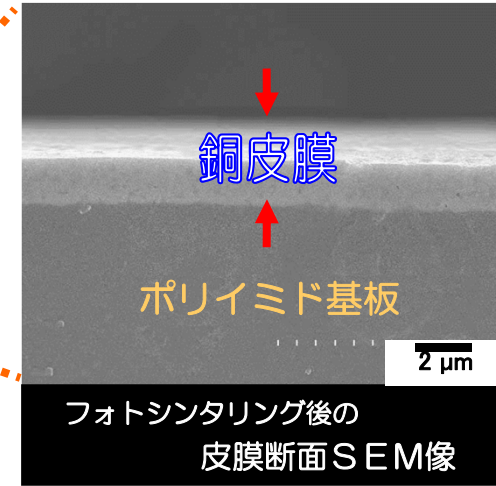
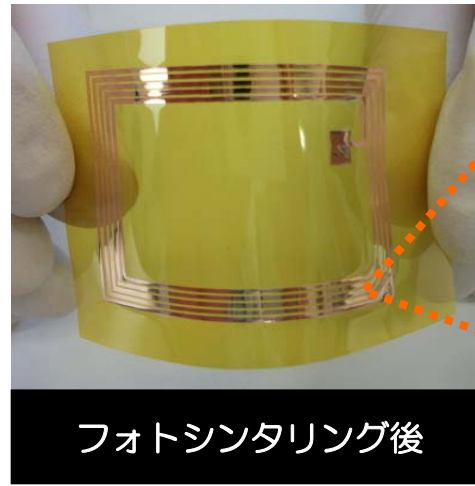
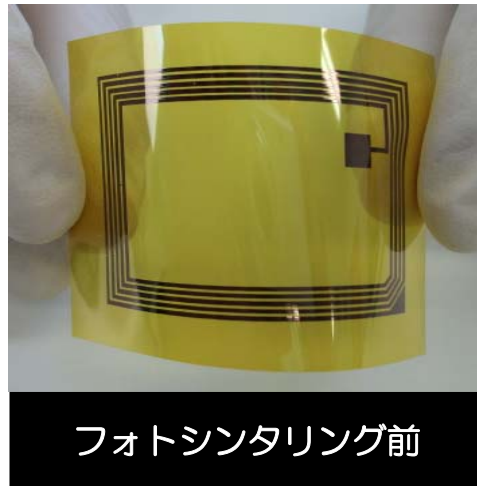


## 3.フォトシンタリング

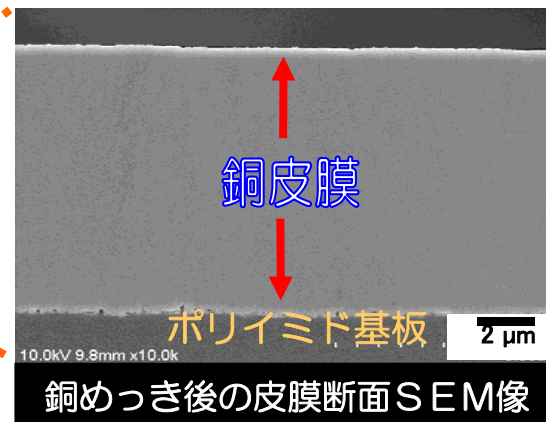
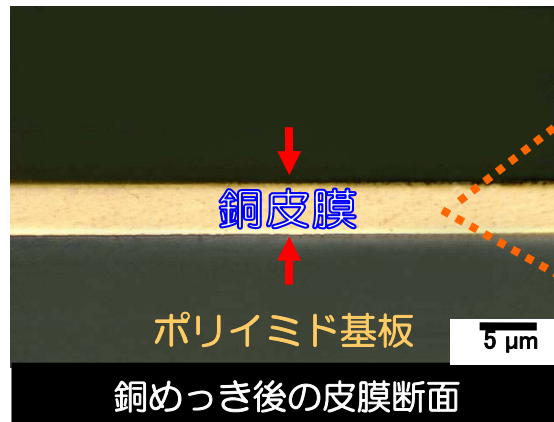
雰囲気 : 大気下、室温  
焼成時間 : 1秒以下(数マイクロ秒)



## フォトシンタリング前後の銅回路外観と銅皮膜断面SEM像



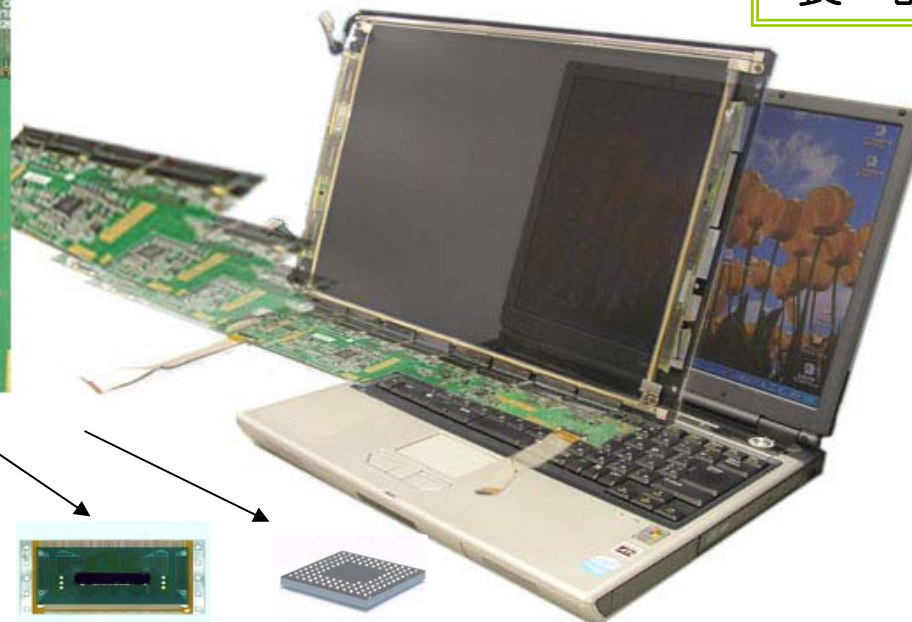
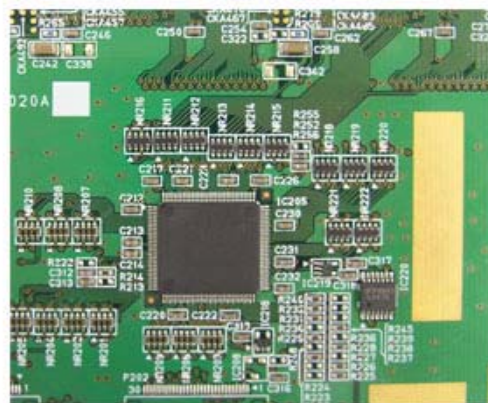
## 銅めっきにより増膜した皮膜の断面像



# ●めっき製品紹介

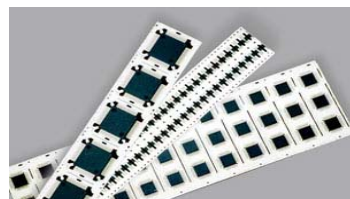
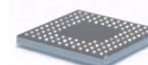
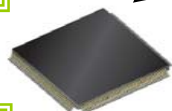
基板

製品



部品

めっき



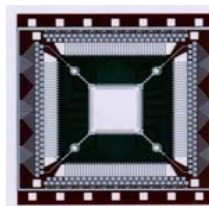
IC半導体部品



チップ部品



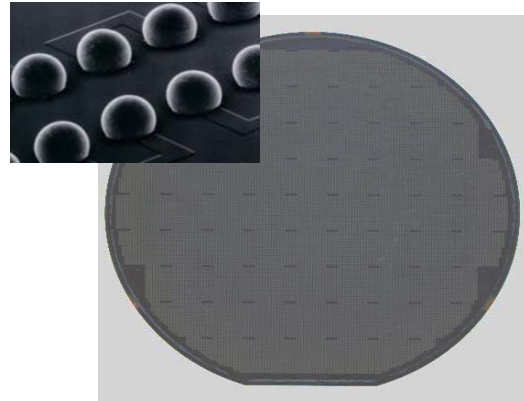
TAB/COF部品



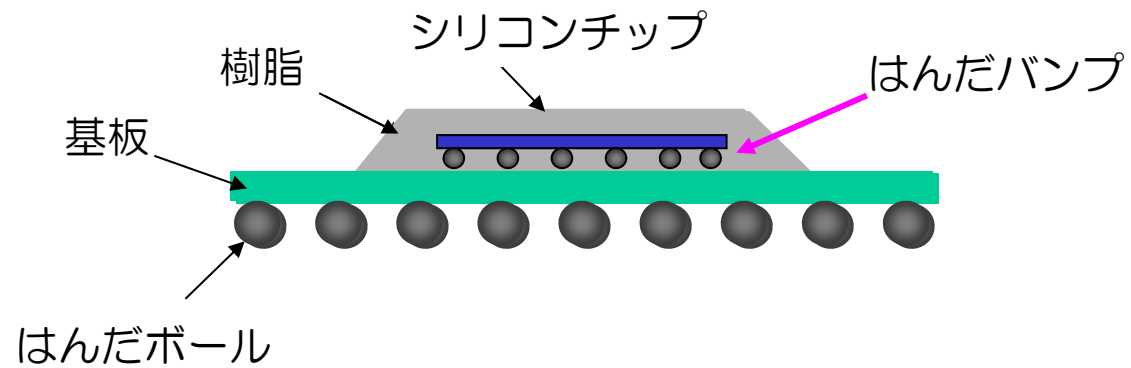
バンプ部品



# はんだバンプを使用したBGAパッケージの構造

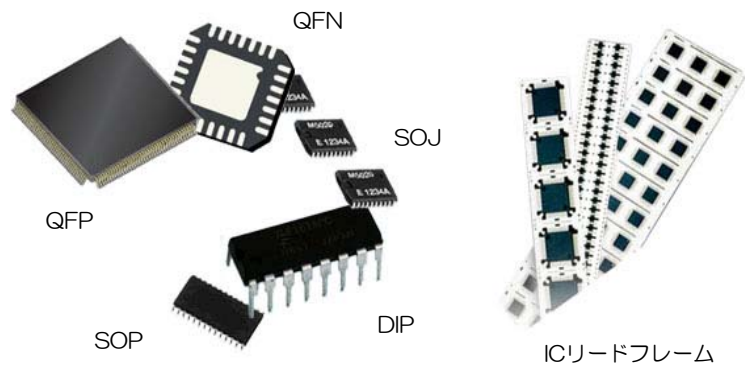


ウェハー

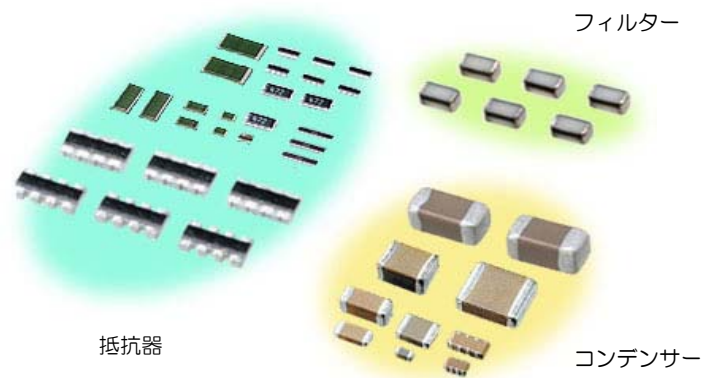


# ● 部品紹介

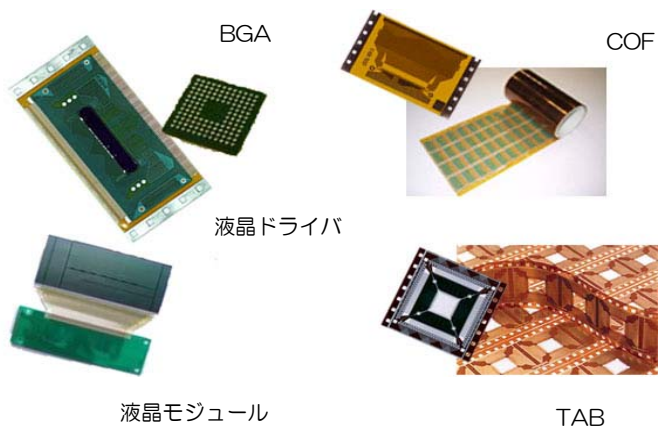
## IC半導体部品



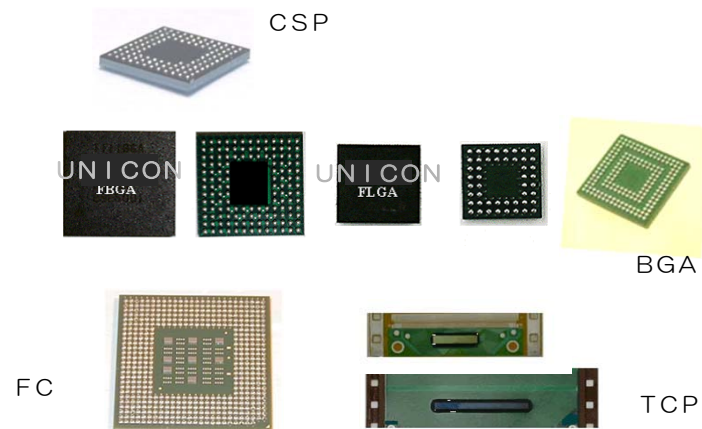
## チップ部品



## TAB/COF部品



## bumps 使用部品



# 《参考資料》

- 経営の基本方針
- 当社の特徴
- 営業品目別売上高推移  
(平成13年度実績～平成23年度予想)
- 研究開発人員と研究開発費
- 業績の推移と配当
- 総資産・純資産・1株当たり純資産・自己資本比率の推移
- 展示会出展予定のご案内

# 経営の基本方針

## 経営の基本方針

- (1) 当社は自己開発・商品開発・市場開発の「三つの開発」を企業理念とし、ニッチ市場といわれる事業分野で高い市場占有率を維持し、基幹となる3つの分野で事業をバランスよく展開し、各々の収益力を高め、総体として会社の業績の伸長をはかる。
- (2) このような事業活動を通じて常に新しいニーズの創造・発掘に取り組み、会社の発展を通じて、株主・取引先・従業員など関係各位の信頼と期待に応え、社会に貢献していく。

企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に努める。

全てのステークホルダーの満足度向上

# 当社の特徴

## 事業領域

界面化学を中核技術に3つの分野で4つの事業を展開  
「全天候型経営」による事業リスクの分散

## ニッチ市場で高い占有率

はんだめっき液で国内トップシェア  
鉛フリー製品（環境配慮型製品）

## 研究開発型企业

強固な研究開発体制

- ① 全従業員の1/3程度を研究開発人員に充てる
- ② 研究開発費 ⇄ 売上高の増減により変動するが、概ね製品売上高10%程度を投入する
- ③ 各大学・試験所との連携による研究開発

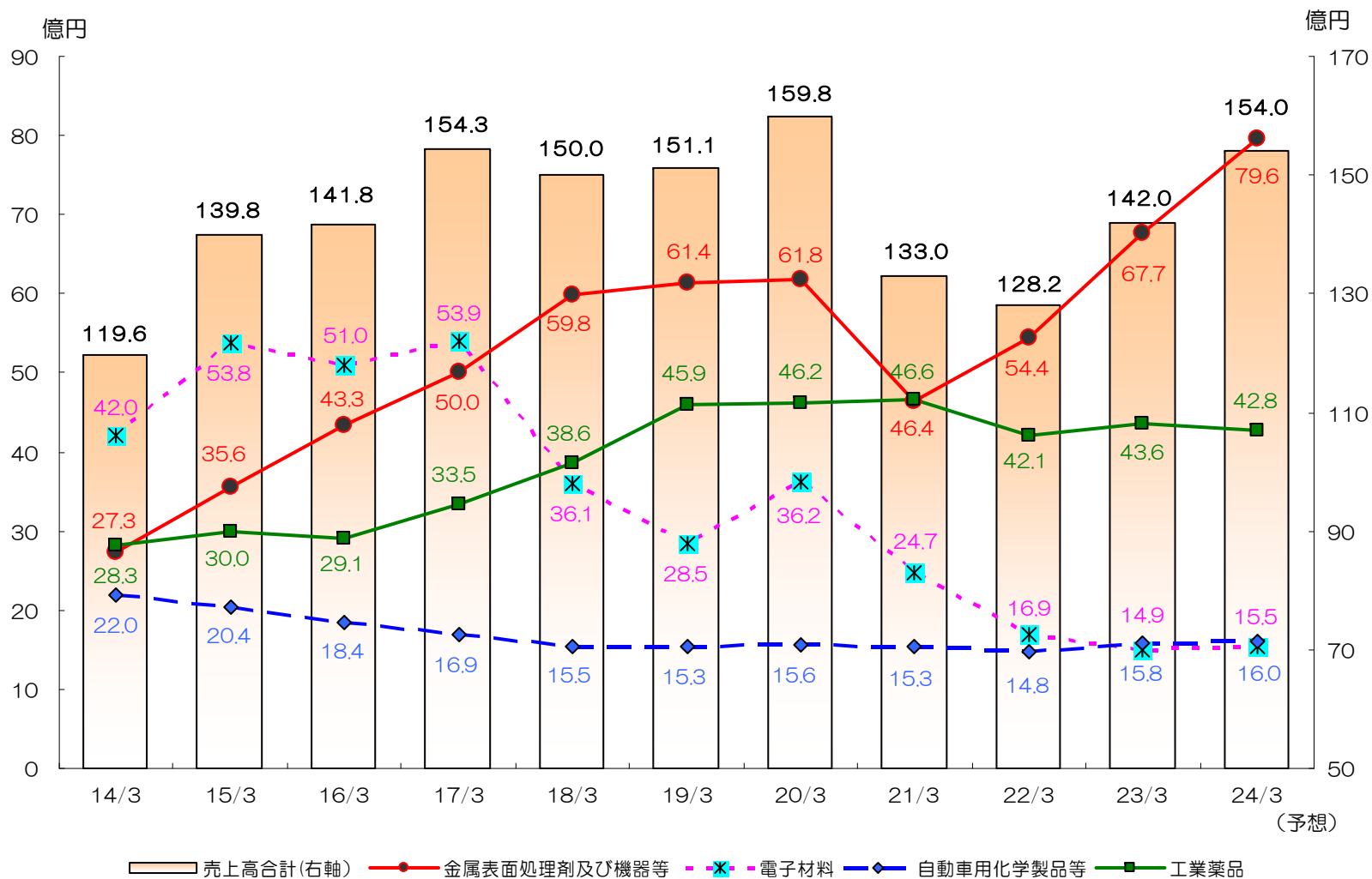
## 技術サポート

技術サポート力を基盤に、技術フォローまで含めた高付加価値サービスの提供

安定した事業基盤、財務基盤に基づくパートナー企業との信頼関係の上で  
新製品開発・新市場開発を展開しています。



# 営業品目別売上高推移（平成13年度実績～平成23年度予想）



業績予想数値につきましては、現時点において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。

## 研究開発人員と研究開発費

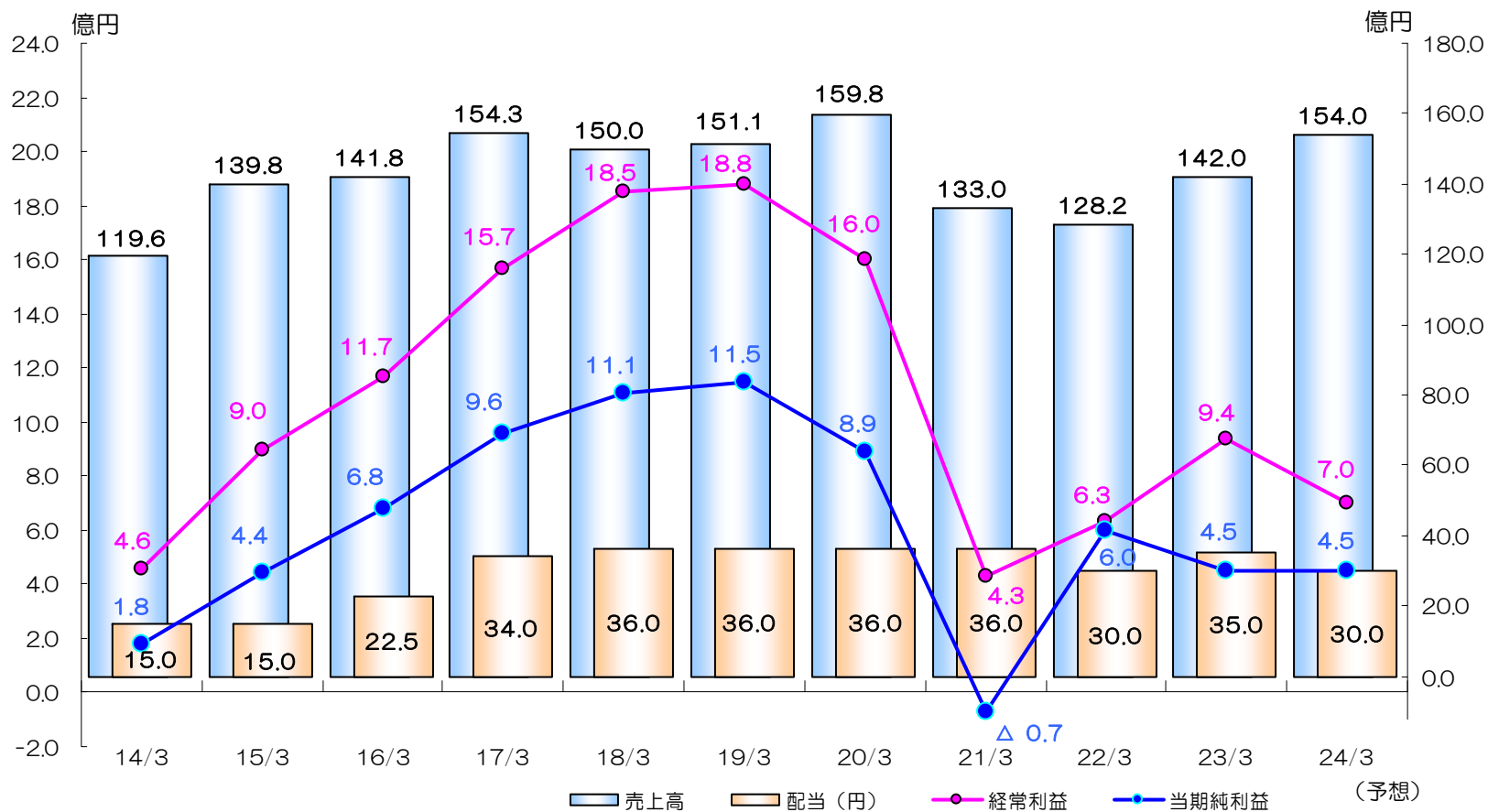
	18/3	19/3	20/3	21/3	22/3	23/3	24/3 (予想)
従 業 員	180	182	178	183	182	184	197
研究開発人員	53	55	58	62	63	72	81
割 合	概ね1/4が研究開発要員 ⇒ 1/3へ						

(単位：百万円)

研究開発費	639	680	724	770	798	786	940
研究開発用設備取得 (リース資産も含む)	54	104	111	68	117	75	260
製品売上高 研究開発比率	8.7%	9.1%	10.0%	14.2%	14.5%	12.9%	16.7%

研究開発型事業の多い当社では、守秘義務契約により進められているプロジェクトが多くそれら詳細情報の開示には制限が課せられております。

# 業績の推移と配当



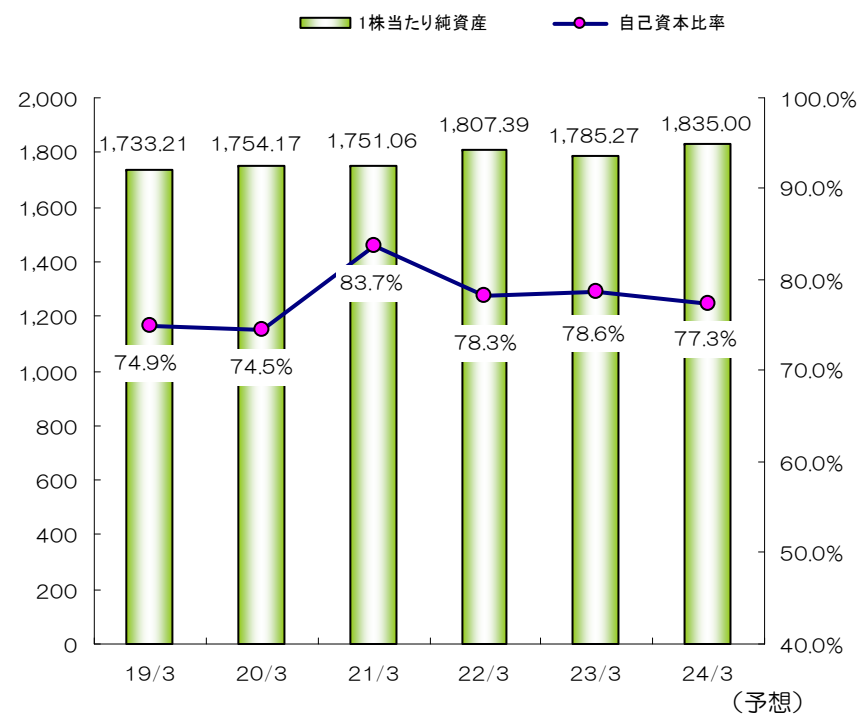
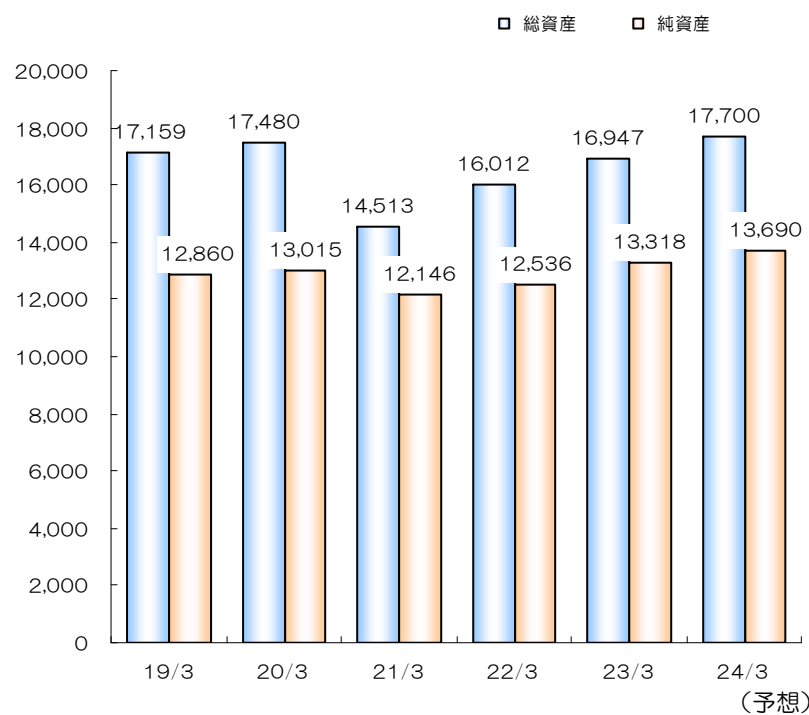
	14/3	15/3	16/3	17/3	18/3	19/3	20/3	21/3	22/3	23/3	24/3 (予想)
配当性向	60.35%	26.44%	25.35%	26.98%	24.81%	23.23%	29.73%	—	34.44%	53.30%	49.73%



業績予想数値につきましては、現時点において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。

## 総資産・純資産・1株当たり純資産・自己資本比率の推移

		19/3	20/3	21/3	22/3	23/3	24/3 (予想)
総資産	【Total Assets】 (百万円)	17,159	17,480	14,513	16,012	16,947	17,700
純資産	【Shareholders Equity】 (百万円)	12,860	13,015	12,146	12,536	13,318	13,690
1株当たり純資産	【BPS】 (円)	1,733.21	1,754.17	1,751.06	1,807.39	1,785.27	1,835.00
自己資本比率	【Equity Ratio】 (%)	74.9%	74.5%	83.7%	78.3%	78.6%	77.3%



## 展示会出展予定のご案内

アジア最大のエレクトロニクス製造・実装技術展

# インターネプコン ジャパン 2012

- 日時 2012年1月18日（水）～ 20日（金）
- 場所 東京ビックサイト 西ホール

出展を予定しております

第41回 **インターネプコン ジャパン**  
エレクトロニクス製造・実装技術展

<http://www.nepcon.jp/About/Concurrent-Shows/>

- この資料に掲載されている業績見通し、その他今後の予測・戦略等に関わる情報は、本資料の作成時点において当社が合理的に入手可能な情報に基づき、通常予測し得る範囲内で為した判断に基づくものです。しかしながら現実には、通常予測し得ないような特別事情の発生または通常予測し得ないような結果の発生等により、本資料記載の業績見通しとは異なる結果を生じ得るリスクを含んでおります。
- 当社といたしましては、投資家の皆様にとって重要と考えられるような情報について、その積極的な開示に努めてまいります。本資料記載の業績見通しのみ全面的に依拠してご判断されることはくれぐれもお控えになられるようお願い致します。
- なお、いかなる目的であれ、当資料を無断で複製、または転送等をおこなわれぬようお願い致します。

ありがとうございました

平成23年11月

石原薬品株式会社

(東証二部・大証二部)

URL: <http://www.unicon.co.jp>